

使用上的注意事项

过度的机械和热应力有时会损坏电容器的介电陶瓷。注意避免馈通电容器的跌落或对其施加剧烈的机械冲击和热冲击。

■ 底盘架板的焊接

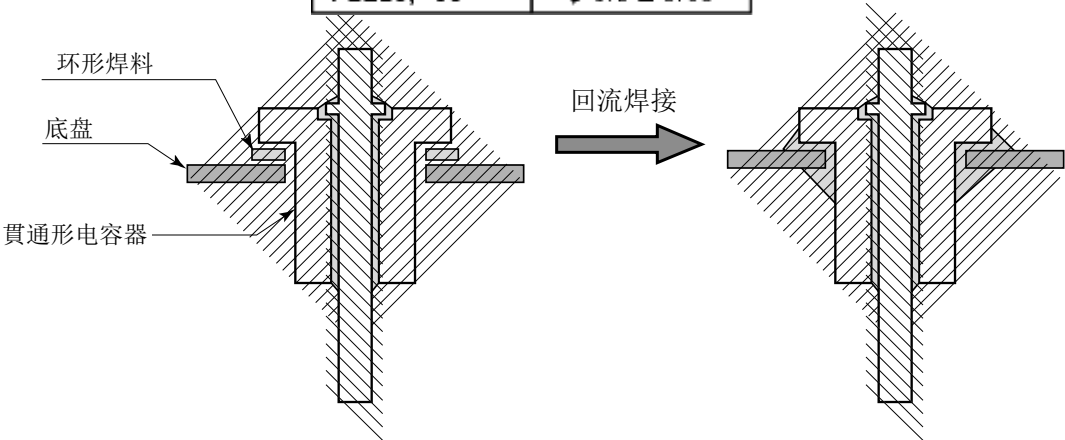
1. 请使用回流焊接
- 关于使用的焊料

请使用熔点（液态状）220℃以下的焊料。
- 关于焊接条件

以130～150℃进行预热，然后在回流区的最高温度250℃以下处理，持续时间在10秒钟以内。

2. 推荐使用的底盘孔尺寸一览表

形式	孔径
PLE123	$\phi\ 1.6 \pm 0.05$
PLE12, 22, 32	$\phi\ 2.1 \pm 0.05$
PLE255	$\phi\ 2.6 \pm 0.05$
PLE23, 33	$\phi\ 3.2 \pm 0.05$



■ 焊接插针

1. 建议在以下条件下焊接插针。
- 推荐的条件

请使用热容量尽可能大的烙铁头。
烙铁头最高温度300℃以下，施加时间不得超过10秒钟，焊接时尽可能远离电容器本体3mm以上。
2. 使用时请不要折弯插针，如果不得以需要折弯插针的情况下，尽量避免对电容器本体施加机械性的压力。

■ 最小包装数量

1. 无插针类型

系列	数量（个/袋）	袋最大可装入 数量（个/袋）
PLE123	1,000	5,000
PLE12, 22, 32, 255, 23	1,000	15,000
PLE33	1,000	10,000

2. 有插针类型

500 个 / 袋（适用于任何尺寸）
